



2011年10月18日発表プレスリリースより

ロジャースコーポレーションと日立化成工業株式会社は高速デジタルアプリケーション用のPCB材料に関する業務提携をすることで合意いたしました。これにより、インターネットやビデオ配信サービスに使用する毎秒1Gビット以上の通信速度で処理するサーバーやルーター、通信機器などの高速デジタル市場に対して、より幅広い製品群を提供し、技術サービスの向上や納期の短縮などが可能になります。

今回の合意の背景には、2008年に締結された契約書があり、両社間で製品を融通し、より幅広いラインナップをもって両社の自社ブランド名でマーケットに供給するというものでした。新しい合意書の前では、ロジャースは日立化成工業㈱が提供するプリプレグを使用したラミネート製品を独占的に製造し、これらの高速デジタルPCB材料を日立化成工業㈱の特定の顧客以外へ独占的に販売する権利を有することになりました。今回の合意書により、ロジャースはより後半な高周波基板材料を市場に提供し、日立化成工業はロジャースの世界的な販売網を通してその最先端製品の市場拡大が可能になります。また、両社は、協同して新しい高速デジタルPCB材料を開発することでも合意しています。

この業務提携の最初の目的としては、HSD市場でTHETA材料の共同ブランドのもとロジャースが現在提供している日立化成の低損失ハロゲンフリーHSD用配線板材料

「MCL-HE679G」の採用を世界的に拡大することです。そして更にロジャースは日立化成の低伝送損失HSD用配線板材料「MCL-FX-2」とGFA-2（プリプレグ）の販売を世界市場において拡大する予定です。

ロジャースのACM部門の上級副社長のマイク・ベセッテのコメント：

「ロジャースは日立化成との提携を強化することを大変喜ばしく思っています。両社の提携により世界生産、新製品開発、顧客サポートにおける強みが増加し、それにより、世界中の顧客に強力なHSD用配線板材料ソリューションを提供できます。また、両社でネットワークインフラ市場における顧客に競争力のある提案ができるようになります。」

日立化成の執行役 配線板材料事業部長 中川操氏のコメント：

「日立化成はこの提携によりHSD市場において製造、商品開発、顧客サービスの優秀なサポートシステムを確立したいと希望しています。この提携でHSD用配線板材料ソリューションにおける両社の強みを活用したいと考えています。私達は、両社で総合的な製品、サポートソリューションを提供することにより、私達の価値を最大限にし、また、市場でのリーダーと認知されたいと考えます。」